



# 能够通过MC33775A进行ETPL通信的 HVBMS集中式单体监测单元(CMU)

## RD33775ACNTEVB

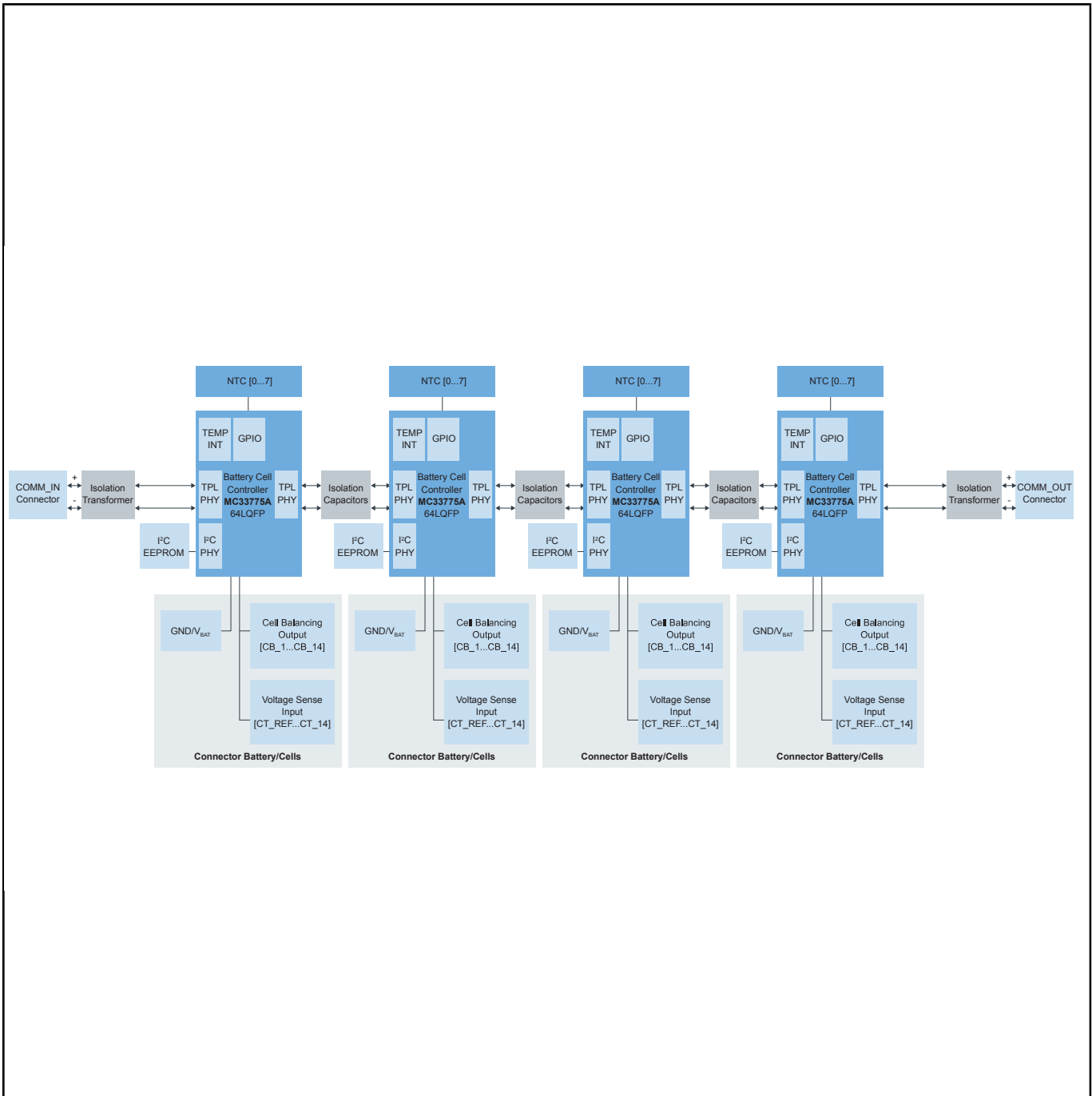
Last Updated: Sep 21, 2022

此产品适用于部分客户(需要保密协议(NDA))。如需了解更多信息和样品供货情况, 请联系支持人员或当地销售代表。

RD33775ACNTEVB是具有电子传输协议链路(ETPL)通信的集中式单体监控单元(CMU)参考设计。它是高压电池管理系统(HVBMS)硬件和软件快速成型的理想之选。该评估板还包含以菊花链形式连接的四个MC33775A模拟前端(AFE)。

该评估板属于使用ETPL的 RD-HVBMSCTBUN HVBMS参考设计包。

# 使用ETPL和MC33775A-RD33775ACNTEVB的HVBMS集中式单体监测单元 Block Diagram



View additional information for [能够通过MC33775A进行ETPL通信的HVBMS集中式单体监测单元\(CMU\)](#).

**Note:** The information on this document is subject to change without notice.

**[www.nxp.com](http://www.nxp.com)**

NXP and the NXP logo are trademarks of NXP B.V. All other product or service names are the property of their respective owners. The related technology may be protected by any or all of patents, copyrights, designs and trade secrets. All rights reserved. © 2024 NXP B.V.